# 福建省工业和信息化厅文件

闽工信行政服务〔2026〕83号

## 福建省工业和信息化厅关于渠梁电子有限公司高性能逻辑芯片及高带宽内存芯片封装改扩建项目节能报告的审查意见

渠梁电子有限公司:

你公司《关于申请高性能逻辑芯片及高带宽内存芯片封装改扩建项目节能审查的请示》及有关材料收悉，项目代码2607-350582-07-02-265968。项目新增崩应炉、测试机、点胶机、电浆清洗机、分类机、焊线机、脚平面度检查机、上片机、流焊炉、助焊剂清洗机、高速组装线（CAB-BP）等主要生产设备，以及配套公用工程及辅助生产设施，建设3条高性能逻辑芯片封装生产线和3条高带宽内存芯片封装生产线。项目备案总投资60亿元，达产后将新增年封装高性能逻辑芯片24000片、年封装高带宽内存芯片1440万颗的生产能力。根据《中华人民共和国节

约能源法》第十五条和《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》（国家发展和改革委员会令2025年第31号）等有关法律法规规章，经审查，具体意见如下:

一、根据你公司提供的节能报告，该项目为改扩建项目，内容符合《福建省固定资产投资项目节能审查实施办法》（闽发改规〔2023〕9号）等相关要求。项目以晶圆、基板、环氧树脂、光刻胶、电镀液、金线银线、锡球及显影液、蚀刻液等为主要原料封装生产高性能逻辑芯片和高带宽内存芯片。项目根据工艺流程特点配备高效节能的生产设备，新增主要用能设备包括崩应炉、测试机、流焊炉、助焊剂清洗机等，未采用国家明令淘汰和限制的落后设备，重点用能产品设备能效达到节能水平。

项目拟于2028年6月建成投产。项目达产后，新增年综合能源消费量18862.51tce（当量值）、42987.64tce（等价值），含原料用能消费量153.86tce，化石能源消费量910.59tce；其中，年消耗电力14481.74万kWh、天然气73.75万m³、柴油10.32t、氢气35.28万m³。项目新增年碳排放量62609.32t$CO_2$。核算项目集成电路封装单位产品能耗0.1279kgce/千个引脚。项目新增综合能源消费量将纳入泉州市“十五五”期间能源消费统计范围，对泉州市完成“十五五”能耗强度下降目标将产生影响。

综上，我厅原则同意所报项目节能报告通过审查。

二、你公司要严格按照《节能报告》的建设方案进行施工，将节能技术措施落实到项目建设和生产的各环节中。项目在开工建设前或建设过程中建设地点、建设内容、建设规模等发生重大变动，应及时向我厅提交变更申请。项目建成投入生产、使用前，应依法对项目节能报告中的生产工艺、用能设备、节能技术等采用情况以及节能审查意见落实情况进行验收，并在完成验收后30日内向我厅报送节能验收报告。递交验收报告前，项目不得投入生产、使用。项目投产后，企业应建立健全能源管理体系，完善能耗在线监测系统并有效运行。

三、请泉州市、晋江市工信局依据本审查意见，加强事中事后监管，对项目设计、施工、竣工验收以及运营管理实施有效监督检查。

本审查意见自印发之日起2年内有效，逾期未开工建设或建成时间超过节能报告中预计建成时间2年的项目应重新进行节能审查。

福建省工业和信息化厅

2026年10月28日

（此件主动公开）

抄送：省节能办，省节能中心，泉州市、晋江市工信局。

福建省工业和信息化厅政务服务中心　　2026年10月28日印发